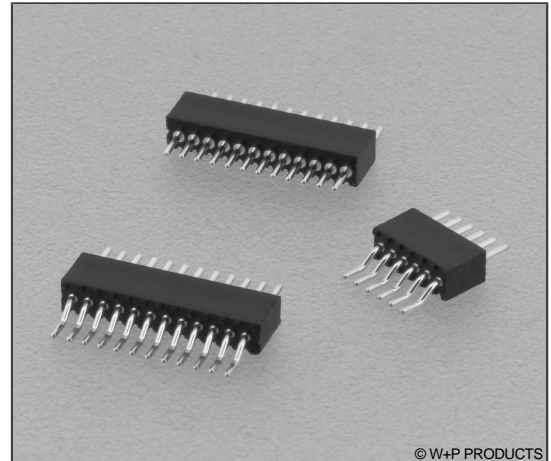


## SMT-Präzisions-Stiftleisten RM 1,00mm, liegend, 1-reihig SMT Precision Pin Headers, 1.00mm Pitch, Horizontal, Single Row

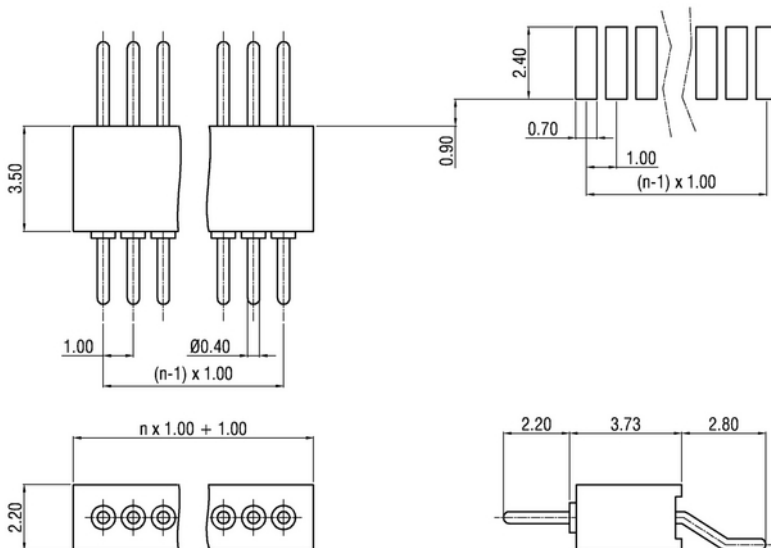
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Rundkontakt Ø0,40mm, Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Ø0.40mm round contact, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>&lt; 10mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	100V <sub>RMS</sub> /150V <sub>DC</sub>
<i>Test Voltage</i>	<i>100V<sub>RMS</sub>/150V<sub>DC</sub></i>
Nennstrom	1A
<i>Current Rating</i>	<i>1A</i>
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
<i>Temperature Range</i>	<i>-55°C ... +125°C</i>
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
**7090**



#### Series

**7057**

#### Contacts\*

**08**

03-50

#### Plating\*

**10**

10 Vergoldet 0,25µm  
0.25µm gold plated  
50 Verzinkt  
Tin plated

#### Packaging\*

**TR**

ST  
TR (Option)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

#### Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes  
TR (Option) Tape & Reel / Tape & Reel

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

